

Title (en)  
Blister pack assembly

Title (de)  
Blisterpackungsanordnung

Title (fr)  
Dispositif d'emballage du type blister

Publication  
**EP 2080502 A1 20090722 (DE)**

Application  
**EP 08100536 A 20080116**

Priority  
EP 08100536 A 20080116

Abstract (en)  
The blister pack arrangement has a blister pack, which has a cavity (7) for receiving a medication dosage and a closure film. Each medication dosage is squeezed out through the closure film by pressing out the respective cavity for sampling. A conductive path carrier is aligned relative to the cavities of the blister pack such that a conductor (1) is disconnected within the surface by pressing out the medication dosage. The surface is defined by perpendicular projection of the cavity on the conductive path.

Abstract (de)  
Eine Blisterpackungsanordnung weist einen Leiterbahnträger mit einer Leiterbahn (1) auf, die über die durch senkrechte Projektion der Kavitäten (7) auf den Leiterbahnträger definierten Flächen verläuft, so dass die Leiterbahn (1) durch Herausdrücken einer Medikamentendosis durch eine dieser Flächen unterbrechbar ist. Das Reißen eines Stegteils (2) am Umfang der durch senkrechte Projektion einer Kavität (7) auf den Leiterbahnträger definierte Fläche wird dadurch vermieden, dass das zu durchtrennende Stegteil (2) in die durch senkrechte Projektion der Kavität (7) auf den Leiterbahnträger definierte Fläche hinein verlegt wird. Gegenüber der herkömmlichen Ausführung eines Stegteils (2) am Rand der durch senkrechte Projektion der Kavität (7) auf den Leiterbahnträger definierten Fläche ergeben sich so günstigere Krafteinleitungsverhältnisse, welche das Stegteil (2) leichter reißen lassen. Alternativ kann auch auf das Stegteil (2) ganz verzichtet und ein innerhalb der durch senkrechte Projektion der Kavität (7) auf den Leiterbahnträger definierten Fläche angeordneter Stanzlinienabschnitt direkt mit der Leiterbahn (1) überdruckt werden.

IPC 8 full level  
**A61J 1/03** (2006.01); **B65D 75/36** (2006.01)

CPC (source: EP)  
**A61J 1/035** (2013.01); **A61J 2200/30** (2013.01)

Citation (applicant)  
• DE 102004060213 A1 20050728 - SIMON UDO [DE], et al  
• EP 1507248 A1 20050216 - SCHREINER GROUP GMBH & CO KG [DE]

Citation (search report)  
• [DX] DE 102004060213 A1 20050728 - SIMON UDO [DE], et al  
• [X] US 5412372 A 19950502 - PARKHURST LARRY E [US], et al  
• [XA] US 6973371 B1 20051206 - BENOUALI NADIR [US]  
• [A] WO 2007138520 A1 20071206 - NXP BV [NL], et al

Cited by  
CN103413206A; GB2484660A; GB2484660B; CN103415448A; AU2011315317B2; US8973773B2

Designated contracting state (EPC)  
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT RO SE SI SK TR

Designated extension state (EPC)  
AL BA MK RS

DOCDB simple family (publication)  
**EP 2080502 A1 20090722; EP 2080502 B1 20111123**; AT E534365 T1 20111215; EP 2242469 A1 20101027; EP 2242469 B1 20160504; WO 2009090048 A1 20090723

DOCDB simple family (application)  
**EP 08100536 A 20080116**; AT 08100536 T 20080116; EP 09701699 A 20090114; EP 2009000177 W 20090114